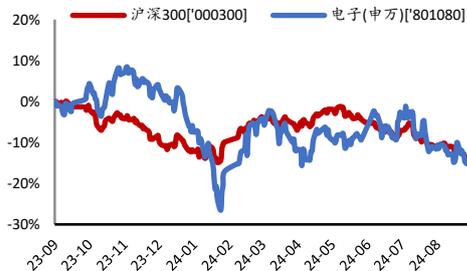


电子行业周报 (9.09-9.15)

强于大市 (维持评级)

关注端侧 AI+折叠屏等创新技术的加速渗透

一年内行业相对大盘走势



电子行业估值 (PE)



团队成员

分析师 杨铮
执业证书编号: S0210522110003
邮箱: yz3979@hfzq.com.cn

联系人 詹小瑁
邮箱: zxm30169@hfzq.com.cn

相关报告

《关注9月10日华为&苹果发布会》——
2024.09.08

《关注9月10日苹果秋季发布会》——
2024.09.01

《关注《黑神话:悟空》对AI PC及高清显示行业的带动》——2024.08.25

投资要点:

- ▶ **华为发布全球首款三折叠屏手机Mate XT。** Mate XT作为全球首个三折叠手机,引领了折叠屏手机形态的持续创新,开启三折叠屏手机的崭新时代。此次新品的发布,华为在屏幕材料、铰链设计等核心硬件环节深度研发,实现升级。屏幕部分,华为Mate XT三折叠展开10.2英寸,展开薄至3.6毫米,这是由于华为创新性引入多向弯折柔性材料,从而可实现整机超薄。在纤薄的基础上, Mate XT亦保持抗冲击和坚韧,它采用非牛顿流体和322cm²超大UTG玻璃,组成复合超韧结构,双重抗冲,使其屏幕抗冲击性能实现了75%的提升。铰链部分,华为Mate XT搭载天工铰链系统,让铰链系统第一次实现内外弯折;同时铰链100%核心的部件均采用了超强火箭钢,抗变形强度达1900Mpa。华为Mate XT汇聚了最新的自研高端材料和专利技术成果,打破了智能终端形态的边界,加速折叠屏手机不断渗透。
- ▶ **折叠屏插上AI翅膀,应用前景进一步拓宽。** 值得注意的是, Mate XT搭载了华为强大的AI技术,支持AI扩图、AI消除、AI云增强等AI智慧体验。此前,三星于7月10日首次发表AI折叠旗舰机Galaxy Z Fold6/Flip6,在AI赋能下,其应用场景、交互体验不再是一板一眼的单痛点解决方案,比如搜索图片、文本转存至笔记等,而是一套由AI驱动的完整交互逻辑。传统手机算力芯片及存储单元,在面临多任务并行、大容量音视频及图片、文档处理时略显吃力,难以将折叠机多屏及大屏优势尽数发挥。而对于折叠屏,其凭借大屏幕、多屏幕的优势在娱乐、办公等应用广受消费者追捧,在AI赋能下,其不再局限于折叠形态带来的与直板手机截然不同的场景应用,而是AI赋能下的体验重构——打破以硬件为锚点的革新困局。据CINNO Research数据,24Q2中国折叠手机搭载AI技术的销量占比42%,同比大幅上升42pct,环比上升10pct, AI技术的应用,有望成为折叠手机的标配功能。
- ▶ **AI赋能+三折硬件形态加持下,折叠屏手机加速成长。** 凭借诸多品牌的靓丽表现,折叠屏手机正处于高速渗透阶段,据财联社转引Counterpoint数据,全球折叠屏手机出货量将从2022年的1310万台增至2027年的1亿台,2022-2027年CAGR达50.6%。而中国已成为全球最大折叠屏市场,据CINNO Research数据,24Q2中国折叠屏手机销量达262万部,同比+125%,环比+11%,同比、环比双增长,已连续四个季度保持三位数同比增长幅度。而折叠屏手机的高速发展将带动柔性OLED、屏幕盖板、铰链等核心部件产业链的发展。据集微网转引UBI Research数据,2024年用于折叠手机的OLED面板出货量达994万片,24Q2折叠手机OLED出货量占智能手机OLED出货量的5.2%,创历史第二高;而据CINNO Research数据,2022年国内折叠手机前盖板UTG搭载量约110万,并将以65%的CAGR继续成长至2025年的近500万台。展望未来,在AI大模型和三折等创新形态的合力加持下,叠加良品率的提升和价格的下探,折叠屏手机整体渗透率有望快速增长,而深耕折叠机材料和零部件的相关企业,有望在其发展中充分受益。
- ▶ **投资建议:** 盖板材料方面,建议关注核心原材及其加工工艺的国产化技术进展,相关企业有:凯盛科技、长信科技、瑞华泰等。结构件方面,建议关注相关材料及其配套加工工艺的持续迭代,相关企业有:福蓉科技、东睦股份、精研科技、统联精密、金太阳、宇环数控等。
- ▶ **风险提示:** 技术发展及落地不及预期;终端出货不及预期;下游需求不及预期;市场竞争加剧风险;地缘政治风险;行业景气不及预期。

正文目录

一、	本周市场表现.....	3
1.1	电子板块本周表现.....	3
1.2	SW 电子个股本周表现	3
1.3	电子板块估值分析.....	4
二、	行业动态跟踪.....	6
2.1	半导体板块.....	6
2.2	AI 板块.....	6
2.3	消费电子板块.....	12
2.4	汽车电子板块.....	13
2.5	面板板块.....	16
三、	公司动态跟踪.....	18
四、	风险提示.....	19

图表目录

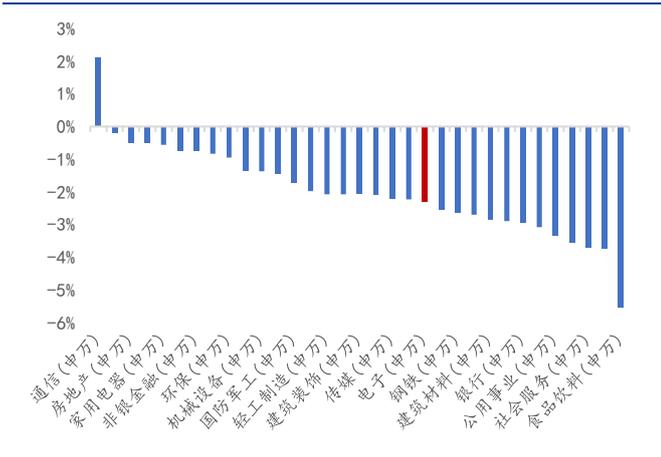
图表 1:	SW 各行业板块本周市场表现.....	3
图表 2:	电子板块成交额及日涨跌幅.....	3
图表 3:	电子细分领域本周涨跌幅 (%)	3
图表 4:	SW 电子本周涨幅前十个股 (%)	4
图表 5:	SW 电子本周跌幅前十个股 (%)	4
图表 6:	SW 电子本周换手率前二十个股 (%)	4
图表 7:	SW 电子行业指数 PE 走势 (TTM)	5
图表 8:	SW 电子细分行业指数 PE 走势 (TTM)	5
图表 9:	过去一周股东增减持更新	18
图表 10:	过去一周股权激励一览.....	19

一、 本周市场表现

1.1 电子板块本周表现

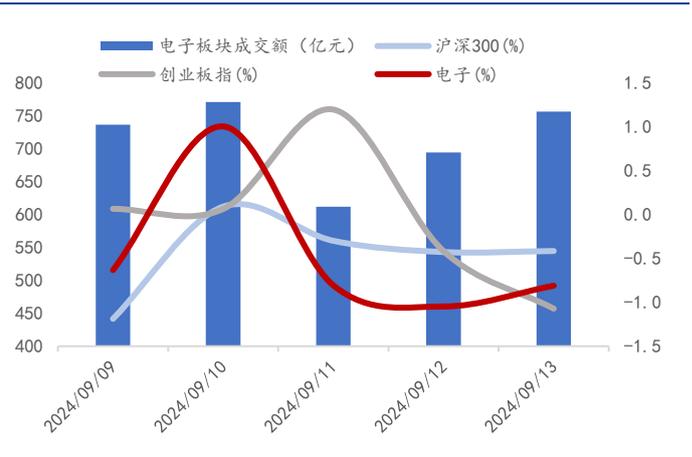
大盘表现上，本周（0909-0915）创业板指数下跌 0.19%，沪深 300 指数下降 2.23%。本周电子行业指数下跌 2.29%。行业表现上，电子行业涨跌幅位列全行业的第 19 位，本周通信、房地产、计算机板块涨跌幅位居前列。

图表 1：SW 各行业板块本周市场表现



数据来源：Wind，华福证券研究所

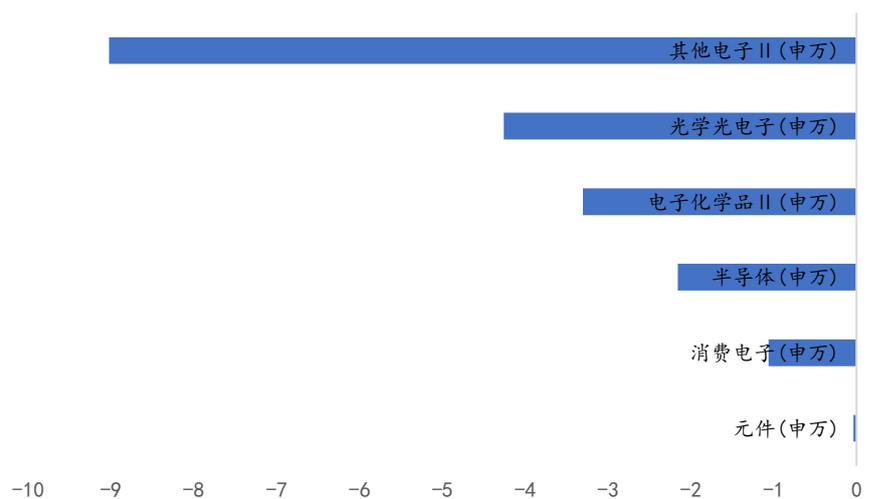
图表 2：电子板块成交额及日涨跌幅



数据来源：Wind，华福证券研究所

从电子细分行业指数看，本周电子细分板块涨跌幅均呈下降态势，具体来看，元件板块跌幅最小，周涨跌幅为-0.04%；其他电子块跌幅最大，周涨跌幅为-9.02%。

图表 3：电子细分领域本周涨跌幅 (%)

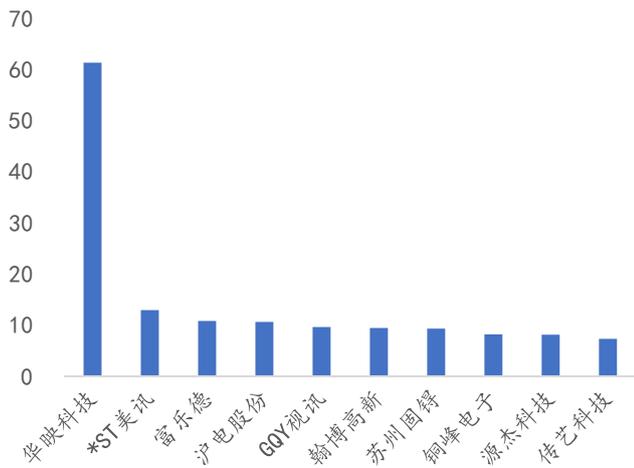


数据来源：Wind，华福证券研究所

1.2 SW 电子个股本周表现

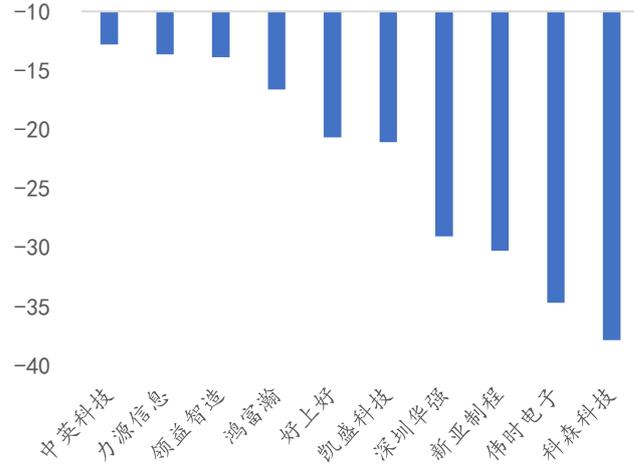
从个股维度来看，SW 电子板块中，华映科技 (61.33%)、*ST 美讯 (12.96%) 等位列涨幅前列；科森科技 (-37.85%)、伟时电子 (-34.70%) 等位列跌幅前列。

图表 4: SW 电子本周涨幅前十个股 (%)



数据来源: Wind, 华福证券研究所

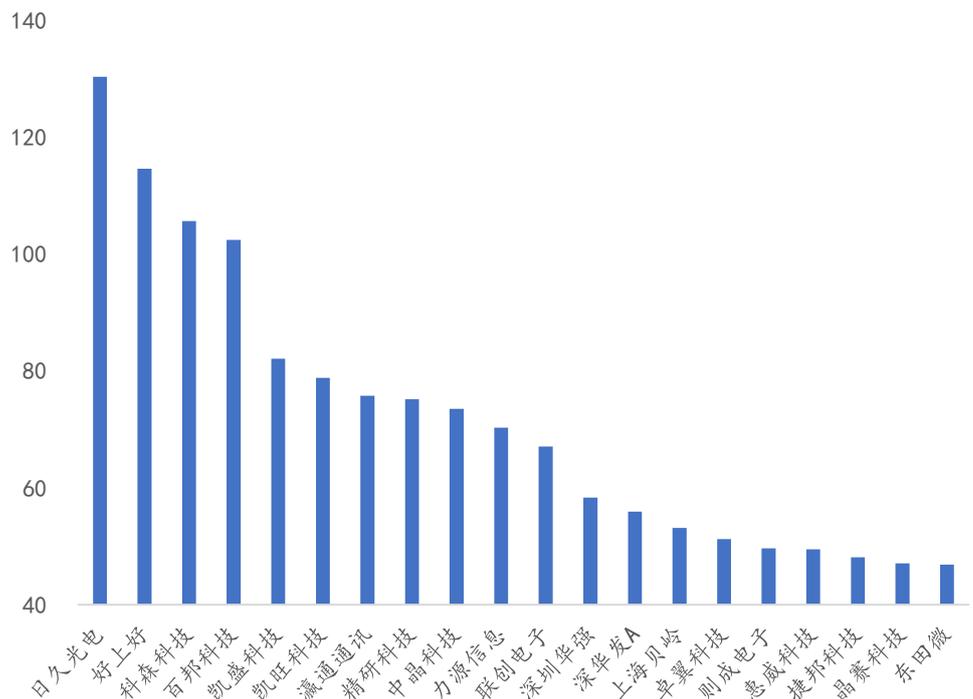
图表 5: SW 电子本周跌幅前十个股 (%)



数据来源: Wind, 华福证券研究所

从换手率来看,本周电子行业个股换手率最高的是日久光电,换手率为 130.30%。其余换手率较高的还有好上好 (114.59%)、科森科技 (105.61%)、百邦科技 (102.41%)。

图表 6: SW 电子本周换手率前二十个股 (%)



数据来源: Wind, 华福证券研究所

1.3 电子板块估值分析

从本周 PE 走势来看,整体电子行业估值低于近一年、五年平均值水平,但高于近三年平均值水平。本周 PE (TTM) 为 38.64 倍,较上周有所下调。

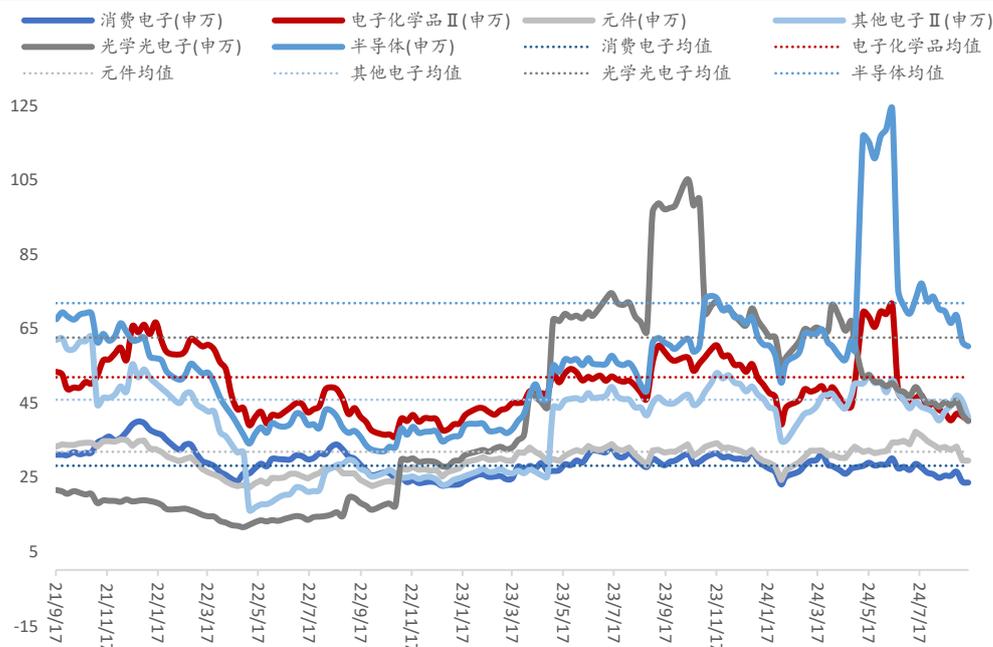
图表 7: SW 电子行业指数 PE 走势 (TTM)



数据来源: Wind, 华福证券研究所

细分领域上, 本周消费电子、电子化学品、元件、其他电子、光学光电子和半导体板块 PE 分别为 23.51、40.18、29.43、41.14、40.04 和 60.16, 本周电子细分板块估值均有一定程度回落。

图表 8: SW 电子细分行业指数 PE 走势 (TTM)



数据来源: Wind, 华福证券研究所

二、行业动态跟踪

2.1 半导体板块

1) SIA: 半导体谷底已过 2024 年全球销售增至 6000 亿美元

美国半导体行业协会（SIA）发布了年度行业状况报告。该报告强调了半导体行业持续增长和创新的机遇，并指出了半导体行业持续成功所面临的当前和即将到来的挑战。

报告指出，2023 年，半导体行业全球销售额达到 5270 亿美元，全球共售出近 1 万亿个半导体产品，相当于全球每人拥有超过 100 个芯片。随着市场周期性低迷期的结束和对半导体需求的高涨，世界半导体贸易统计预计，2024 年的销售额将增至 6000 亿美元以上。

需求不断增长，为提高芯片产量，新的产业投资不断涌现。美国半导体部分得益于美国《芯片法案》，预计其制造能力将提高两倍多，并且新的私人投资将在半导体制造领域中占据更大份额。

SIA 指出，事实上，自美国《芯片法案》首次提交国会以来，半导体生态系统中的公司已宣布在美国开展 90 多个新的制造项目，在 28 个州共投资近 4500 亿美元。这些投资预计将创造数万个直接就业机会，并为整个美国经济提供数十万个额外的就业机会。该行业正在世界各国进行投资，以建立一个更强大、更有弹性的供应链。

美国本土芯片供应链的加强与扩大同时带来巨大的机遇和挑战。例如，随着业务不断扩大，对人才的需求也会增加；此外，政策也存在挑战，包括持续实施《芯片法案》，加强美国在半导体研究、设计和制造领域。

在芯片生产和上游材料产能方面，其他国家的政府也特别关注提高供应链的弹性，以减少战略依赖。业界致力于确保全球半导体供应链的弹性，进一步促进全球市场的准入，并通过深化国际合作促进全球贸易的增长。

总体而言，半导体行业已做好长期增长的准备。随着全球创新的不断增加，对半导体的需求也将不断增加，半导体将成为创新进步的基础。

SIA 最后提到，半导体在社会中发挥的作用从未像今天这样重要，我们行业的未来也从未像今天这样光明。（资料来源：集微网）

2) 机构: 2032 年单晶硅市场营收将增至 201 亿美元

据市场调查机构 Allied Market Research 的《单晶硅晶圆市场》报告指出，2022 年单晶硅晶圆市场价值为 109 亿美元，预计到 2032 年将达到 201 亿美元，2023 年~2032 年的复合年均增长率（CAGR）为 6.4%。

人们和企业希望减少碳足迹并转向更可持续的能源，市场对太阳能的需求正在迅

速增长，这也是单晶硅片行业的重要驱动因素之一。不断增长的电子产品的需求也推动了单晶硅片市场的增长，因为单晶硅片广泛用于生产微芯片、LED 和传感器等电子设备。单晶硅片因其高纯度、高均匀性和优异的电气性能而广泛用于电子设备的生产。此外，对电子产品日益增长的需求继续推动市场的增长，这得益于物联网（IoT）的发展、人工智能（AI）在各个行业的使用增加以及电动汽车的日益普及等因素。

按类型细分的市场来看，2022 年市场 6 英寸细分市场最高。不过，预计 12 英寸细分市场将成为预测期内增长最快的细分市场。6 英寸单晶硅片的流行主要得益于其在集成电路（IC）和其他微型器件制造以及可再生能源行业太阳能电池板中的应用，这是单晶硅片市场的新趋势之一。

从按销售渠道细分的市场来看，2022 年市场以直接渠道细分市场为主。单晶硅片的直接渠道细分市场是该市场的重要组成部分，其驱动因素是节约成本和加强供应链控制的需求。

从应用来看，半导体市场份额很高。不过，太阳能细分市场很可能是增长最快的细分市场。

从地区来看，2022 年市场以亚太地区为主。此外，预测期内，单晶硅片市场增长预计在亚太地区最高。亚太地区的一个主要优势是该地区有许多发展中国家，因此有许多快速增长的公司正在掌握先进技术。综合起来，这为购买和使用单晶硅片提供了重要机会。

报告中介绍的单晶硅片市场参与者包括：隆基绿能、卡姆丹克太阳能集团、世创电子材料、麦斯克电子材料股份、信越化学工业、有研半导体硅材料有限公司、Pure Wafer、香港电业自动工程有限公司、胜高公司和明徽能源股份有限公司。这些公司采取了合作与伙伴关系、产品发布和收购等各种策略来扩大其在单晶硅片市场的立足点。（资料来源：集微网）

3) 美光量产 12 层 HBM3E 36GB 芯片，产品正在进行客户验证

美光推出适用于下一代人工智能（AI）GPU 的量产版 12 层 HBM3E 芯片，内存堆栈容量高达 36GB，速度超过 9.2Gb/s。美光表示，目前正在将可供制造的（production-capable）12 层第五代 HBM（HBM3E）送交给 AI 产业链重要合作伙伴，以进行验证程序。

美光 9 月 9 日正式宣布推出 12 层堆栈的 HBM3E 内存。新产品具有 36GB 容量，旨在用于 AI 和 HPC（高性能计算）工作负载的前沿处理器，例如英伟达的 H200 和 B100/B200 GPU。

美光的 12 层 HBM3E 内存堆栈拥有 36GB 容量，比之前的 8 层版本（24GB）高出 50%。容量增加使数据中心能够在单个处理器上运行更大的 AI 模型。此功能消除了频繁卸载 CPU 的需要，减少了 GPU 之间的通信延迟，加快了数据处理速度。

在性能方面，美光的 12 层 HBM3E 堆栈可提供超过 1.2TB/s 的内存带宽，数据传输速率超过 9.2Gb/s。据美光称，该公司的 HBM3E 不仅提供的内存容量比竞争对手高出 50%，功耗也低于 8 层 HBM3E 堆栈。

美光的 12 层 HBM3E 包含一个完全可编程的内存内置自检 (MBIST) 系统，以确保为客户提供更快的产品上市时间和可靠性。该技术可以全速模拟系统级流量，从而对新系统进行全面测试和更快的验证。

美光的 HBM3E 内存设备与台积电的 CoWoS 封装技术兼容，该技术广泛用于英伟达的 H100 和 H200 等 AI 处理器封装中。

据悉，美光已开始开发其下一代内存解决方案，包括 HBM4 和 HBM4E。这些即将推出的内存类型将继续满足 AI 处理器（包括基于 Blackwell 和 Rubin 架构的英伟达 GPU）对高级内存日益增长的需求。（资料来源：集微网）

4) AI 芯片需求强劲，台积电 8 月营收增长 33%至 2509 亿元新台币

台积电 8 月营收增长 33%，这对押注智能手机市场复苏和英伟达人工智能 (AI) 芯片持续需求的投资者来说是一个积极信号。

台积电 8 月份销售额达到 2509 亿元新台币（78 亿美元），低于 7 月份 45% 的增长速度。分析师预计，第三季度台积电的营收将增长 37%，延续 2023 年疫情后的复苏势头。

该业绩结果有助于缓解市场对 AI 基础设施支出的持久性的担忧。9 月 3 日，英伟达公布的收益未能达到最高预期，导致该公司股价下跌 2790 亿美元，创下单日最大跌幅。

台积电目前一半以上的收入来自高性能计算(HPC)，该业务部分由 AI 需求驱动。

台积电是英伟达的首选芯片制造商，也是苹果 iPhone 主处理器的主要制造商。苹果最新发布 iPhone 16 系列手机“从头开始”为 AI 打造，但其功能将通过软件更新逐步添加到设备中。华尔街押注移动设备需求将反弹。

分析师 Charles Shum 表示，苹果在 iPhone 16 和 iPhone 16 Pro 上采用 Wi-Fi 7，这应该会加速该技术渗透，并刺激对台积电 N6 (7nm) 和 N4 (5nm) 节点的需求，这些节点已被博通、联发科等公司用于 Wi-Fi 7 芯片生产。苹果 A18 和 A18 Pro 处理器性能提升符合预期，这进一步增强了对台积电 N3E 节点（第二代 3nm）销售增长的乐观预期。

台积电在上次报告收益时对其业务和前景进行了乐观评估。今年 7 月，台积电将其全年增长预期上调至高于 20% 区间中段。

随着市场的好转，台积电董事长魏哲家正在带头进行大规模的全球扩张。台积电已宣布在美国亚利桑那州的项目上取得初步进展，正考虑在日本建立第三家晶圆厂，

并于几周前在德国动工建造一座价值 100 亿欧元的晶圆厂。（资料来源：集微网）

5) SEMI 全球副总裁居龙：预计今年中国半导体设备交货金额将再创新高

今年以来，业内对全球半导体市场发展情况作出了越来越积极的判断。9 月 11 日，SEMI 全球副总裁、中国区总裁居龙在 IC World 大会上表示，从半导体设备投资情况来看，今年第二季度全球半导体市场增长乐观。居龙预测称，2024 年中国地区半导体设备交付额预计将在去年基础上再次增长，超过 400 亿美元，继续保持全球第一的市场地位。

根据 SEMI 统计的全球半导体产业投资情况，自 2020 年至今，全球半导体厂房和设备投资持续增长。居龙表示，即便是在整个半导体行业走入下行周期的 2023 年，半导体工厂和设备投资额也没有减缓。根据统计数据，100 多家新的半导体制造工厂在 2022 年至 2026 年之间投入运营，这意味着今年与明年的半导体设备投资仍存在较大增长空间。

在全球半导体制造行业积极投资的版图中，中国的半导体设备销售额贡献率最高。中国半导体设备销售额 2023 年达到 360 亿美元，同比增长 28.3%，在全球半导体设备销售市场中居首。

居龙表示，今年上半年半导体设备在中国地区的交货金额已经达到 230 亿美元，预计今年全年设备交货金额将超过 400 亿美元，继续保持自 2020 年以来全球第一的市场地位。

根据 SEMI 对全球主要半导体设备公司市场份额的统计数据，2024 年，中国市场在日本半导体设备企业 Tokyo Electron、荷兰半导体设备企业 ASML 的营收占比有所上升，在美国企业应用材料的营收占比则有所下滑。

关于未来带动半导体市场的几大新技术、新机遇，居龙给出了三个关键词：AI、新能源汽车、先进封装。在 AI 方面，全球 IT 行业对计算设施的投资将逐年增加，预计至 2027 年，包括云端、汽车、消费端、PC 等应用市场在内的 AI 半导体设备营收的年复合增长率将达到 31%。在新能源汽车方面，汽车半导体价值规模将持续增长，预计到 2026 年，汽车半导体市场规模将增长至 990 亿美元。在先进封装方面，各海外龙头均在加大扩产力度，但扩产难度大、周期长，新建工厂普遍需要 2 至 3 年才能量产，短期内先进封装产能缺口难以解决，将持续供不应求。（资料来源：集微网）

6) AI 驱动集成电路行业持续向好，Q2 全球半导体销售额同比增长 18.3%

经历前两年周期性下滑后，全球半导体产业 2024 年逐步迎来复苏。今年上半年，我国集成电路行业表现突出，芯片制造、芯片设计企业营收普遍好转；AI 成为驱动产业增长的重要力量，GPU 芯片和高带宽内存（HBM）芯片等需求快速增长；与此同时，半导体设备需求持续旺盛，中国市场已连续多个季度稳坐全球最大半导体设备市场宝座。

半导体市场企稳复苏

告别 2023 年全球半导体行业下行周期后，今年半导体产业逐步迎来复苏。美国半导体行业协会（SIA）发布数据显示，2024 年第二季度全球半导体销售额同比增长 18.3%，环比增长 6.5%，总额达到 1499 亿美元。SIA 总裁约翰·纽费尔表示，该季度销售额刷新了两年半来的记录。

另据国际半导体产业协会（SEMI）统计，2024 年第二季度全球硅晶圆出货量环比增长 7.1%，达到 30.35 亿平方英寸。SEMI SMG 主席李崇伟表示：“硅晶圆市场正在复苏，这得益于与数据中心和生成式人工智能产品相关的强劲需求。越来越多的新半导体晶圆厂正在建设中或扩大产能。这种扩张以及向一万亿美元半导体市场迈进的长期趋势，将不可避免有更多的硅晶圆需求。”

在全球产业复苏背景下，我国集成电路产业今年表现更为突出。国家统计局数据显示，今年 1 至 7 月，我国集成电路产量达 2445 亿块，同比增长 29.3%。

其中，中芯国际上半年营收约 262.69 亿元，同比增加 23.2%；今年第二季度，公司营收 19.0 亿美元，同比增长 21.8%。公司预计第三季度收入环比将增长 13%至 15%。中芯国际联席首席执行官赵海军在业绩发布会上称，公司今年全年总体格局已基本确定，目标是销售收入增幅超过同业的平均值，下半年销售收入超过上半年。

华虹半导体上半年营收 9.39 亿美元，净利润 3850 万美元。公司产能利用率逐步提升，至二季度，8 英寸产能利用率超过 100%，12 英寸产能利用率接近满产，连续两个季度营收环比正增长。华虹半导体总裁兼执行董事唐均君表示：“半导体市场在经历了数个季度的持续疲软后，在部分消费电子等领域带动下出现了企稳复苏信号。第二季度，华虹半导体的销售收入达到 4.785 亿美元，毛利率为 10.5%，均实现了环比增长。”

AI 成为重要驱动力

随着大模型时代加速来临，AI 行业发展越来越偏重 GPU 算力底座，全球算力需求快速增长。研究机构 Gartner 预测，2024 年全球人工智能（AI）半导体总收入将达到 710 亿美元，较 2023 年增长 33%。工信部等六部门印发的《算力基础设施高质量发展行动计划》提出，2025 年我国算力规模将超过 300 EFLOPS，智能算力占比达到 35%。目前，智能算力市场份额大多数被国际厂商的 GPU 所垄断，近两年国产 AI 芯片快速发展，正在逐步获得越来越多的落地应用。

在 2024 世界人工智能大会上，国产 GPU 厂商燧原科技、天数智芯、摩尔线程等集中展示了各自的智能算力解决方案。近日，燧原科技国产万卡集群点亮仪式在甘肃省庆阳市举行，标志着国产算力集群搭建取得了阶段性成果。在 AI 大模型领域，万卡通用算力将成为标配。

国产 GPU 厂商景嘉微上半年实现营收 3.5 亿元，同比增长 1.4%；净利润为 3415.43

万元，同比扭亏为盈。公司表示坚定看好 GPU 未来广阔的发展前景，全力推进由“专用”到“专用+通用”的发展战略，瞄准 GPU 在人工智能领域的应用方向，持续开展高性能 GPU、模块及整机等产品的研发。

存储芯片行业今年同样普遍回暖。根据集邦咨询最新存储器产业报告，受惠于需求成长、供需结构改善拉升价格，加上 HBM（高带宽内存）等高附加价值产品崛起，预估内存（DRAM）及闪存（NAND Flash）产业 2024 年营收将分别增加 75%和 77%。

多家国产存储公司半年报显示，存储市场景气度进一步上升。江波龙上半年实现营业收入 90.39 亿元，同比增长 143.82%，归母净利润 5.94 亿元，同比增长 199.64%。佰维存储实现营业收入 34.41 亿元，同比增长 199.64%，归母净利润 2.83 亿元，扭亏为盈。兆易创新实现营业收入 36.09 亿元，同比增长 21.69%，归母净利润 5.17 亿元，同比增长 53.88%。兆易创新表示，经历 2023 年市场需求低迷和库存逐步消化后，2024 年上半年消费、网络通信市场出现需求回暖，带动公司存储芯片的销量和营收增长。

当前，大模型参数指数级增长对 AI 服务器需求激增，而 AI 服务器迭代对内存带宽、存储容量需求的提升使得 HBM 成为核心升级点。开源证券认为，全球 HBM 市场规模在 2023 年至 2027 年复合增速有望达到 50.9%。集邦咨询预估 2024 年 HBM 将贡献内存芯片出货量的 5%和营收的 20%。

半导体设备需求持续旺盛

从半导体周期来看，随着人工智能技术迅猛发展，算力和高性能存储芯片成为产业链的关键节点，也推动了集成电路装备的需求增长。2024 年第一季度，中国大陆的半导体设备销售额高达 125.2 亿美元，同比激增 113%，连续四个季度稳坐全球最大半导体设备市场宝座。SEMI 近期发布《年中总半导体设备预测报告》显示，2024 年半导体制造设备全球总销售额将达到 1090 亿美元，创下新的行业纪录；2025 年的销售额将创下 1280 亿美元的新高。

产业复苏形势下，国内晶圆厂扩产确定性强，带动国内半导体设备公司订单情况良好，成长性凸显。

在前三大国产半导体设备企业中，北方华创上半年实现营业收入 123.35 亿元，同比增长 46.38%；净利润 27.8 亿元，同比增长 54.54%。中微公司实现营业收入 34.48 亿元，同比增长 36.46%；新增订单 47 亿元，同比增长约 40.3%。盛美公司实现营业收入 24.39 亿元，同比增长 49.33%；归母净利润 4.43 亿元，同比增长 0.85%。

总部位于上海的万业企业近日发布半年报显示，2024 年至今，公司获得设备订单约 2.2 亿元，旗下凯世通新增 5 家客户订单，其中 3 家为国内主流客户重复订单，2 家为新增客户订单，是目前国内 12 英寸低能大束流离子注入机产品交付量和工艺覆盖率领先的供应商。2020 年至今，公司累计在集成电路领域获得订单金额近 19 亿元。（资料来源：集微网）

7) AI 领域需求推动，二季度全球 NAND 闪存销售额增至 168 亿美元

9 月 10 日消息，据外媒报道，有市场研究机构发布的报告显示，在人工智能领域需求的推动下，二季度全球 NAND 闪存的销售额环比有明显增加，接近 168 亿美元。

从市场研究机构的报告来看，今年二季度全球 NAND 闪存的销售额为 167.96 亿美元，环比增长 14.2%。

不过，市场研究机构在报告中也提到，在今年二季度，由于 PC 厂商和手机厂商的高库存，二季度全球 NAND 闪存的出货量，其实环比下滑了 1%，但得益于人工智能刺激了大容量存储产品的需求，NAND 闪存的平均售价在二季度环比增长了 15%，不仅抵消了出货量下滑的影响，还明显推升了整体的销售额。

具体到厂商方面，三星电子依旧是销售额最高的厂商，在二季度为 62 亿美元，环比增长 14.8%，所占的份额为 36.9%；SK（包括 SK 海力士及 Solidigm）则是第二大厂商，在二季度的销售额为 37.16 亿美元，环比增长 13.6%，所占的份额为 22.1%。

其他厂商中，铠侠 NAND 闪存在二季度的销售额为 23.26 亿美元，是第三大厂商，环比增长 27.7%，在前五大厂商中的环比增长率是最高的；第四大厂商美光的销售额为 19.81 亿美元，环比增长 15.2%；西部数据的销售额为 17.61 亿美元，环比增长 3.3%。（资料来源：Techweb）

2.2 AI

1) MIC：明年 AI PC、AI 手机渗透率将达 16.8%、25%

随着生成式 AI 时代来临，AI PC、AI 手机广受市场欢迎，资策会 MIC 今（11）日发布终端产品 AI PC 与 AI 手机预测，资深产业分析师曾巧灵表示，2025 年全球 AI PC 渗透率将达 16.8%，全球出货量 4400 万台，并预估全球 AI 手机 2025 年市场渗透率达 25%，全球出货 3.03 亿支，预期 2026 年 AI 手机将渗透至中低阶机种，全球渗透率将在 2028 年突破 6 成。

资策会 MIC 表示，全球半导体市场由 ICT 需求转变为 AI 应用为主要成长动能，在 AI 芯片需求爆炸性成长之下，预估全球半导体市场将在 2027 年达到 7000 至 8000 亿美元规模，且业界已有共识认为 2030 年市场可望突破 1 兆美元。

资策会 MIC 资深产业分析师杨可歆表示，AI 应用将加速逻辑芯片、存储器与封装技术发展，为满足不同的 AI 应用场景，逻辑芯片、存储器、I/O 与封装技术，将需要在性能、功耗与体积之间取得平衡。为求芯片整体性能与功耗效率提升，芯片产业展开变革，技术进步体现于逻辑芯片运算能力、存储器频宽、容量与延迟表现，另外，先进封装技术在整合运算芯片与存储器方面也扮演关键角色，反映现代电子设计面临的挑战，半导体技术整合也更加关键。

随着 GenAI 逐渐落地终端，资策会 MIC 发布终端产品 AI PC 与 AI 手机预测，关于 AI PC，2025 年全球 AI PC 渗透率将达 16.8%，全球出货量 4400 万台，资深产业分析师曾巧灵表示，算力达到 40TOPS 以上的处理器集中在 2024 年下半年推出，因此 2024 年 AI PC 渗透率仍偏低，预期 2025 年随着下一代 AI 处理器与 Arm 架构处理器产品推出，将驱动 AI PC 渗透率提升，预期在 2028 年突破六成，全球出货达 1.63 亿台。

针对 AI 手机，2024 年 GenAI 应用成为各大手机品牌主轴，导入到旗舰与高阶机种，预估 2024 年全球 AI 手机市场渗透率可达 13%，全球出货 1.56 亿支。展望 2025 年，预估全球 AI 手机市场渗透率达 25%，全球出货 3.03 亿支，预期 2026 年 AI 手机将渗透至中低阶机种，全球渗透率将在 2028 年突破六成。

展望 AI PC 与 AI 手机发展，曾巧灵提出三大趋势，首先，AI PC 与 AI 手机发展将推动相关零组件升级，除了关键处理器提供更高算力，存储器也是一大关键，如 PC 的 DRAM 须升级至 16GB，而手机依据不同作业系统呈现差异，最少需要 8GB，不仅如此，存储器本身设计也须大幅改变，才能因应未来 GenAI 手机的进一步需求。除此，散热元件须确保 PC 与手机运作的稳定性，大厂开始规划导入不同的散热解决方案，带动相关供应链发展。

第二，AI PC 应用发展出现一个世界、两套系统，中国大陆因其国产化政策、语系差异及 AI 应用的审查制度，自行发展出一套 AI PC 生态系统。观测全球与中国大陆在优势市场的差异，全球供应链优先布局商用领域 AI 应用、中国大陆则为生态系串接大量消费层级 AI 应用；第三，未来 PC AI 功能可能迈向收费制，而苹果、三星 AI 手机皆可能最终朝向进阶 AI 功能收费服务模式发展。（资料来源：集微网）

2.3 消费电子板块

1) AI 加持 iPhone 16 系列备货大增，A 股核心供应商一览

9 月 10 日，苹果公司在线上举办了名为“高光时刻”（Glowtime）的秋季新品发布会，并推出 iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Max 等新品，前面两款搭载全新的 A18 芯片，后面两款搭载性能更强的 A18 Pro 芯片。其中，苹果人工智能（Apple Intelligence）将于 10 月推出，明年将支持中文。

据多位消息人士透露，苹果公司押注其首款配备 Apple Intelligence 人工智能功能的 iPhone 16 将大获成功，并已告知供应商为大约 8800 万~9000 万部智能手机备货零部件，这比去年 8000 万部新 iPhone 的初始零部件订单有所增长。

业内人士指出，Apple Intelligence 将给 iPhone 16 新机赋能，加快换机周期，苹果将持续打造芯片、系统、硬件创新及端侧 AI 模型的核心竞争力，苹果 AI 技术及硬件创新有望拉动硬件换机需求，苹果 A 股供应链企业有望迎来新一轮业绩增长。

押注 AI 技术

在北京时间 9 月 10 日凌晨举行的新品发布会上，苹果公司发布新款智能手表、AirPods 和 iPhone 16 系列手机。

其中，iPhone 16 系列新机作为首款专为 Apple Intelligence 设计的机型，将搭载全新的 A18 芯片。同时，苹果公司确认人工智能（Apple Intelligence）将在 10 月推出，明年将支持中文。iPhone 16、16 Plus 起售价分别为 799 美元、899 美元。

iPhone 16 Pro 及 iPhone 16 Pro Max 两款机型将分别配备 6.3 和 6.9 英寸的屏幕，搭载性能更强的 A18 Pro 芯片。iPhone 16 Pro 起售价为 999 美元，iPhone 16 Pro Max 起售价为 1199 美元。

苹果公司指出，A18 芯片的 6 核 CPU 速度比 A16 仿生芯片快 30%，且快于所有竞品，能效相比 A16 仿生芯片降低 30%。与 A16 仿生芯片相比，这款芯片的 5 核 GPU 速度提升最高可达 40%，能效提升最高可达 35%。

而 A18 Pro 芯片基于第二代 3 纳米制程工艺打造，拥有 16 核神经网络，配备 6 核 GPU（2 个性能核心+4 个效率核心），运行速度比 A17 Pro 快 15%，能效少了 20%。

据此前消息称，苹果已将“苹果智能”（Apple Intelligence）功能作为今秋门店销售 iPhone 的一个重要组成部分，已开始面向零售员工的有关该功能培训。

苹果 CEO 库克称，尽管尚无法确定“Apple Intelligence”对营收的影响，但苹果一直增加这块业务的支出，已将很多原本从事其他工作的人调到了人工智能（AI）部门。

除此之外，今年 iPhone 16 全系均额外增加了一个“相机控制”物理按钮，用户可以直接通过该按键开启相机，并且可在该按键上以触摸、点击、双击等方式调节相机参数以及拍照、拍视频等。

iPhone 16 系列共有两颗融合式后摄像头，其中包含一颗 4800 万像素主摄和 2 倍长焦，1200 万像素镜头。能够拍摄全新超广角和微距照片，通过融合式镜头得以让 iPhone 16 系列以两颗镜头实现四颗镜头的拍摄效果。

供应链将受益

伴随着苹果迈入 AI 终端时代，业内预计目前 iPhone 活跃用户有望在未来 2-3 年完成 AI 新机换机，有望开启 3 年维度换机潮，国内苹果供应链公司有望深度受益。

据集微网从行业调研得知，A 股中，苹果的核心供应商至少有 30 家，如为苹果提供连接器和声学等产品的立讯精密和歌尔股份、提供盖板玻璃的蓝思科技、提供面板的京东方 A、提供多种零部件的领益智造、提供 PCB 的鹏鼎控股、提供射频频的信维

通信、提供 SIP 的环旭电子和长电科技、提供封装基板的深南电路、提供 LED 芯片的三安光电、提供 NOR Flash 的兆易创新和提供 FPC 的东山精密、提供锂电池的欣旺达和德赛电池、提供复合材料的宝钛股份、提供玻璃棱镜的水晶光电、提供散热材料的中石科技等。

上述企业均为市值比较大的企业，事实上，A 股还有很多小市值企业同样为其供货，尤其是近几年科创板上市公司，虽然市值不大，但业务主要依赖苹果，直接或间接为苹果供货。

据了解，为苹果供货的中小市值企业还有：电磁屏蔽材料厂商隆扬电子、自动化检测设备厂商思林杰、机器视觉厂商智信精密、PVD 真空镀膜单体机汇成真空、光学识别/光学感应测试设备厂商智立方、电子功能性器件厂商博硕科技、提供光学器件的蓝特光学、提供智能制造装备的赛腾股份、提供智能制造设备的赛腾股份、提供检测设备的华兴源创等。

随着苹果 AI 产品的逐步落地，硬件端有望从中受益。其中，果链核心供应商立讯精密下半年的业绩值得期待。事实上，在手机组装业务方面，去年底，立讯集团旗下立臻精密取得和硕昆山厂的控制权，进一步加大 iPhone 制造链中的比重。

领益智造作为苹果结构件及功能件龙头供应商，有望率先受益换机潮带来的出货量提升。同时 AI 手机或迎零部件升级，领益产品布局全面，在 VC 均热板、钢壳电池结构件、快充头等领域均有望前瞻卡位，看好公司相关产品未来有望配合大客户实现产品导入，推动公司营收及利润同步增长。

蓝思科技作为消费电子玻璃盖板龙头，其玻璃盖板在国内占据主导地位，与苹果、三星、小米等国内外知名品牌深度合作。水晶光电也与苹果围绕消费电子产品开展业务合作，公司的红外截止滤光片、窄带滤光片、光学薄膜面板等产品有用在苹果的消费电子产品里。

在显示屏方面，据外媒披露，苹果已经将国内显示屏制造商京东方加入了 iPhone 16 系列的 OLED 显示屏供应商名单中，预计今年就将开始为标准版供货。

有市场研究机构透露，京东方已经成功通过了为 iPhone 16 供货的验证程序，正在按计划进行批量生产，将逐步增加对苹果的出货量。

而瑞声科技作为苹果公司的声学供应商，其相关产品也会实现大幅度增长。据瑞声科技管理层透露，随着智能手机市场进一步发展，未来 AI 手机对语音交互功能需求的提升，也会对手机扬声器音质提出更高诉求。公司将持续推广高性能声学产品，SLS 大师扬声器 2024 年出货量预计将实现 100% 的增长，市场渗透率进一步提升。（资料来源：集微网）

2) 华为 Mate XT 非凡大师正式亮相，开启独一无二的三折叠屏手机崭新时代

9月10日，华为正式召开华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会，华为 Mate XT 非凡大师全球首款商用三折叠屏手机正式亮相。

华为每年都拿出积极创新的态度去打造自家旗舰，最新亮相的华为 Mate XT 非凡大师便是一款颠覆传统认知的创新之作，是全球首款商用三折叠屏手机。

华为 Mate XT 非凡大师全球首发 3K 华为临境大屏，其创新的三折叠屏设计带来一机多能的超形态体验，这款手机配备了华为天工铰链系统，通过精密的机械结构调校，和微米级数字孪生模型的反复调试，实现铰链与屏幕之间的完美搭配；同时其单屏态、双屏态、三屏态多种形态能够满足用户在不同生活场景下的需求，无论是在单屏模式下简单操作，还是双屏态高效处理多种任务，亦或是三屏态带来的更沉浸的大屏体验，每一种形态都为用户提供了独特的视觉享受和高端的操作体验。（资料来源：Techweb）

2.4 汽车电子板块

1) 前 8 月汽车产销量分别增长 2.5%和 3%

近日从中国汽车工业协会获悉，今年 1 至 8 月，我国汽车产销量分别达 1867.4 万辆和 1876.6 万辆，同比分别增长 2.5%和 3%，汽车产销量同比保持稳步增长态势。

据中汽协副秘书长陈士华介绍，8 月份，我国汽车产销量分别达 249.2 万辆和 245.3 万辆，环比分别增长 9%和 8.5%，同比分别下降 3.2%和 5%。

中汽协数据显示，1 至 8 月，我国新能源汽车产销量分别达 700.8 万辆和 703.7 万辆，同比分别增长 29%和 30.9%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的 37.5%。

“汽车行业即将迎来‘金九银十’的传统销售旺季。”陈士华表示，随着报废更新等政策效果逐渐显现，叠加地方置换更新补贴政策陆续生效，将对今年后四个月汽车市场起到积极促进作用，有助于进一步释放汽车市场消费活力。（资料来源：集微网）

2) 乘联会：8 月乘用车零售 190.5 万辆，新能源车零售渗透率 53.9%

9月9日，乘联分会发布 8 月份全国乘用车市场分析报告，8 月全国狭义乘用车零售 190.5 万辆，同比下降 1%；今年以来累计零售 1,347.2 万辆，同比增长 1.9%。其中 8 月常规燃油车零售 87 万辆，同比下降 28%；1-8 月常规燃油车零售 744 万辆，同比下降 15%。8 月国内新能源车零售渗透率 53.9%。

新能源乘用车方面，8 月生产 105.1 万辆，同比增长 32.6%；1-8 月生产 657.2 万辆，同比增长 28.5%。8 月批发销量达到 105.2 万辆，同比增长 31.7%；1-8 月批发

662.2 万辆，同比增长 30.2%。8 月零售 102.7 万辆，同比增长 43.2%；1-8 月零售 601.6 万辆，同比增长 35.3%。

同时，8 月乘用车出口（含整车与 CKD）41.3 万辆，同比增长 24%；1-8 月乘用车累计出口 304 万辆，同比增长 30%。其中，8 月新能源乘用车出口 9.9 万辆，同比增长 23.7%，1-8 月出口 78.7 万辆，同比增长 20.1%。其中，特斯拉 8 月出口 23,241 辆，新能源车出口最多的是比亚迪，达 30,451 辆。（资料来源：集微网）

3) 中汽协：8 月销售新车 245.3 万辆，上汽成出口前十唯一同比下滑车企

9 月 10 日，中汽协发布 8 月汽车工业产销数据称，8 月，我国汽车产销分别完成 249.2 万辆和 245.3 万辆，同比分别下降 3.2%和 5%。1-8 月，我国汽车产销分别完成 1867.4 万辆和 1876.6 万辆，同比分别增长 2.5%和 3%。

其中，乘用车 8 月产销分别完成 222.1 万辆和 218.1 万辆，同比分别下降 2.3%和 4%。1-8 月，乘用车产销分别完成 1614.1 万辆和 1615.7 万辆，同比分别增长 3%和 3.3%。

新能源汽车方面，8 月产销分别完成 109.2 万辆和 110 万辆，同比分别增长 29.6%和 30%，新能源汽车新车渗透率达 44.8%。1-8 月，新能源汽车产销分别完成 700.8 万辆和 703.7 万辆，同比分别增长 29%和 30.9%，新能源汽车新车渗透率为 37.5%。

出口方面，8 月汽车出口 51.1 万辆，同比增长 25.4%。分车型看，乘用车 8 月出口 43.8 万辆，同比增长 25.6%；商用车出口 7.4 万辆，同比增长 24.7%。1-8 月汽车出口 377.3 万辆，同比增长 28.3%；其中，乘用车出口 317.6 万辆，同比增长 29.4%；商用车出口 59.7 万辆，同比增长 22.8%。

8 月前十大出口企业分别为奇瑞（9.8 万辆）、上汽（7.1 万辆）、吉利（6 万辆）、长安（4.5 万辆）、长城（4 万辆）、比亚迪（3.2 万辆）、江汽（2.6 万辆）、东风（2.6 万辆）、特斯拉（2.3 万辆）、北汽（2.3 万辆），上汽是前十中唯一一家 8 月汽车出口同比下滑的车企。（资料来源：集微网）

2.5 面板板块

1) 机构：2028 年中国 OLED 产能将超越韩国，京东方将成全球第一

市场调查机构 Counterpoint Research 最新报告指出，中国显示面板产业持续扩张，2023~2028 年的复合年均增长率（CAGR）8%，预计 2028 年 OLED 产能将超越韩国，成为全球领导者。其中，京东方在 OLED 领域发展迅速，有望于 2028 年超越三星显示（Samsung Display），成为全球第一。

报告指出，2023~2028 年全球显示面板产能 CAGR 预计为 1.4%，其中 OLED 增长较快，达 4.8%。中国在全球显示面板产能占比持续上升，预计从 2023 年的 68%增至 2028

年的 74%。

在 OLED 产能方面，中国预计 2028 年将超越韩国，2023 至 2028 年间的 CAGR 达 8%，为韩国的四倍。其中，京东方预计 2028 年将以 26%对 24%的优势超越三星显示。

此前有消息称，中国显示器公司正在迅速扩大其在智能手机 OLED 市场的主导地位，京东方作为苹果 iPhone 系列的主要供应商取得了重大进展。9 月 5 日消息，据业内人士透露，苹果已将中国京东方、三星显示和 LG 显示 (LG Display) 一起列入 iPhone 16 OLED 面板供应商名单。

据市场研究公司 CINNO Research 统计，今年上半年，OLED 智能手机面板全球出货量份额为京东方 16.1%、维信诺 11.3%、华星光电 9.7%、天马 9%。中国 OLED 市场的快速增长预计将很快超过韩国。

TrendForce 预测，明年 OLED 智能手机面板出货量将较今年增长 3.2%，达到 8.7 亿片。还预测中国面板厂商的市场份额将从今年的 47.9%增至明年的 50.2%，超过韩国企业的 OLED 出货份额。（资料来源：集微网）

三、 公司动态跟踪

图表 9：过去一周股东增减持更新

证券代码	证券简称	公告日期	方向	股东名称	股东身份	拟变动数量上限	拟变动数量上限占总股本比 (%)
300602.SZ	飞荣达	2024-09-09	减持	王林娜	财务总监	25,000.00	0.00
300602.SZ	飞荣达	2024-09-09	减持	王燕	董事, 副总经理, 董事会秘书	111,300.00	0.02
300602.SZ	飞荣达	2024-09-09	减持	刘毅	副总经理	198,300.00	0.03
300602.SZ	飞荣达	2024-09-09	减持	邱焕文	董事, 副总经理	191,700.00	0.03
300602.SZ	飞荣达	2024-09-09	减持	石为民	副总经理	107,000.00	0.02
002185.SZ	华天科技	2024-09-11	增持	天水华天电子集团股份有限公司	控股股东		
688486.SH	龙迅股份	2024-09-12	减持	安徽红土创业投资有限公司	5%以上非第一大股东	197,100.00	0.28
688486.SH	龙迅股份	2024-09-12	减持	合肥中安海创创业投资合伙企业(有限合伙)	5%以上非第一大股东	139,500.00	0.20
688486.SH	龙迅股份	2024-09-12	减持	滁州中安创投新兴产业基金合伙企业(有限合伙)	5%以上非第一大股东	57,700.00	0.08
300709.SZ	精研科技	2024-09-11	减持	邬均文	董事	500,000.00	0.27
688036.SH	传音控股	2024-09-09	增持	张祺	董事, 副总经理		
688036.SH	传音控股	2024-09-09	增持	曾春	董事会秘书		
688036.SH	传音控股	2024-09-09	增持	杨宏	董事, 副总经理		
688012.SH	中微公司	2024-09-14	减持	尹志尧	董事, 监事, 高级管理人员	500,000.00	0.08

688012.SH	中微公司	2024-09-14	减持	倪图强	董事, 监事, 高级管理人员	233,000.00	0.04
688012.SH	中微公司	2024-09-14	减持	刘晓宇	董事, 监事, 高级管理人员	109,870.00	0.02
688012.SH	中微公司	2024-09-14	减持	王志军	董事, 监事, 高级管理人员	20,000.00	0.00
688535.SH	华海诚科	2024-09-11	减持	江苏新潮创新投资集团有限公司	5%以下股东	2,258,197.00	2.80
301282.SZ	金禄电子	2024-09-13	减持	长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业	持股5%以上股东	2,980,000.00	1.97
300787.SZ	海能实业	2024-09-10	减持	东台大盛投资合伙企业	特定股东	1,500,000.00	
300787.SZ	海能实业	2024-09-10	减持	东台和盛投资合伙企业	特定股东	150,000.00	
002130.SZ	沃尔核材	2024-09-13	减持	邱丽敏女士及玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新201号私募证券投资基金, 玄元科新202号私募证券投资基金, 玄元科新203号私募证券投资基金	持股5%以上股东	12,463,300.00	1.00

数据来源: Wind, 华福证券研究所

图表 10: 过去一周股权激励一览

代码	名称	公告日期	方案进度	激励方式	激励总数(万)	激励总数占当时总股本比例(%)	期权初始行权价格
300657.SZ	弘信电子	2024-09-12	董事会预案	上市公司提取激励基金买入流通股	674.12	1.3802	7.04
688371.SH	菲沃泰	2024-09-10	董事会预案	上市公司提取激励基金买入流通股	938.60	2.7978	10.00
688432.SH	有研硅	2024-09-11	董事会预案	上市公司定向发行股票及上市公司提取激励基金买入流通股	1,235.00	0.9899	9.11
688515.SH	裕太微-U	2024-09-13	董事会预案	上市公司提取激励基金买入流通股	60.36	0.7545	32.39
002463.SZ	沪电股份	2024-09-11	股东大会通过	上市公司定向发行股票	3,000.00	1.5665	20.22
002938.SZ	鹏鼎控股	2024-09-14	实施	上市公司提取激励基金买入流通股	946.99	0.4084	17.70
300136.SZ	信维通信	2024-09-10	实施	上市公司定向发行股票及上市公司提取激励基金买入流通股	410.00	0.4237	9.15
688020.SH	方邦股份	2024-09-14	股东大会通过	上市公司定向发行股票及上市公司提取激励基金买入流通股	268.00	3.3222	25.94
688689.SH	银河微电	2024-09-14	股东大会通过	上市公司提取激励基金买入流通股	138.80	1.0768	15.00

数据来源: Wind, 华福证券研究所

四、 风险提示

技术发展及落地不及预期; 下游终端出货不及预期; 下游需求不及预期; 市场竞争加剧风险; 地缘政治风险; 行业景气不及预期。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

一般声明

华福证券有限责任公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料，该等公开资料的准确性及完整性由其发布者负责，本公司及其研究人员对该等信息不作任何保证。本报告中的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，之后可能会随情况的变化而调整。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

在任何情况下，本报告所载的信息或所做出的任何建议、意见及推测并不构成所述证券买卖的出价或询价，也不构成对所述金融产品、产品发行或管理人作出任何形式的保证。在任何情况下，本公司仅承诺以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告以供投资者参考，但不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的承诺或担保。投资者应自行决策，自担投资风险。

本报告版权归“华福证券有限责任公司”所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明

投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有本报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级声明

类别	评级	评级说明
公司评级	买入	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅在 20%以上
	持有	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅介于 10%与 20%之间
	中性	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅介于-10%与 10%之间
	回避	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅介于-20%与-10%之间
	卖出	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅在-20%以下
行业评级	强于大市	未来 6 个月内，行业整体回报高于市场基准指数 5%以上
	跟随大市	未来 6 个月内，行业整体回报介于市场基准指数-5%与 5%之间
	弱于大市	未来 6 个月内，行业整体回报低于市场基准指数-5%以下

备注：评级标准为报告发布日后的 6~12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其中，A 股市场以沪深 300 指数为基准；香港市场以恒生指数为基准；美股市场以标普 500 指数或纳斯达克综合指数为基准（另有说明的除外）。

联系方式

华福证券研究所 上海

公司地址：上海市浦东新区浦明路 1436 号陆家嘴滨江中心 MT 座 20 层

邮编：200120

邮箱：hfyjs@hfzq.com.cn